

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

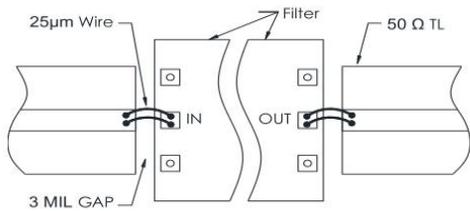
技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		20.65		GHz
工作频率	17.5		23.8	GHz
中心损耗		1.6	2.0	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	14		
带外抑制	@DC-10GHz	65	70	dBc
	@10-14.3GHz	40	45	dBc
	@26.2-28GHz	40	45	dBc
	@28-44GHz	50	55	dBc

环境要求

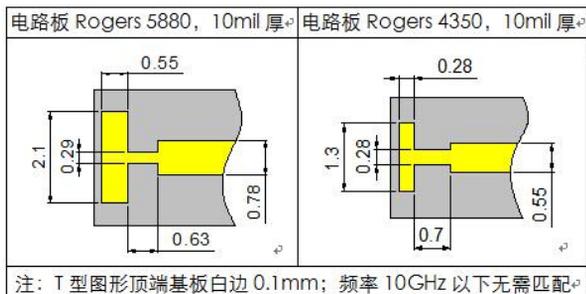
最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图

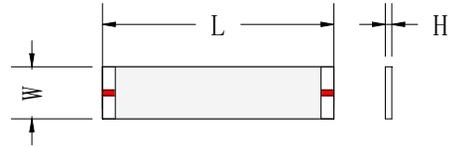


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铜铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.5	2.2	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

